

管理部門 ITソリューション総合展

通称：バックオフィス デー・エクスポ DXPO

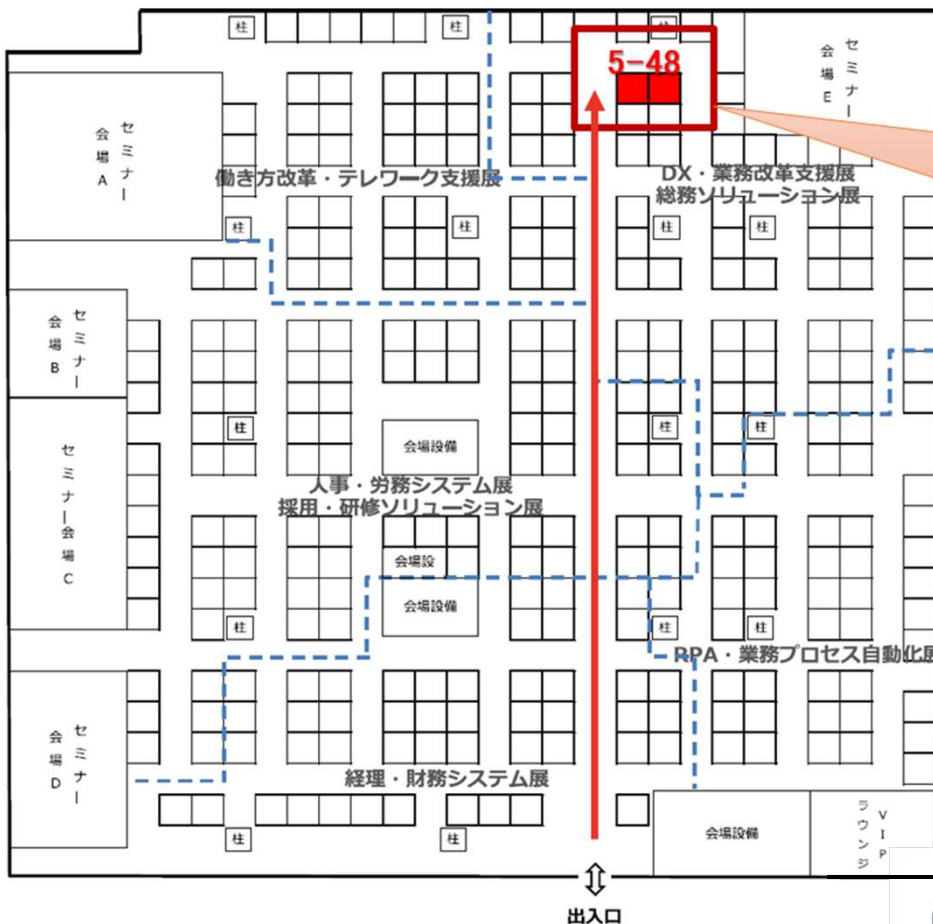
この度、3月14日・15日にインテックス大阪で開催される
ITソリューション総合展に、

RFID備品管理パッケージ「タグ衛門」

配合計量業務パッケージ「smart@scale」

を出展いたします。

実機に触れて、便利さを体感できるこの機会に、是非ご来場ください！



出入口から
まっすぐ
進んでください



ハイエレコンのWebブース

バックオフィス DXPO大阪 '23

会場：大阪市住之江区南港北1丁目5-102
インテックス大阪6号館 小間5-48

<https://dxpo.jp/real/box/osaka23/>

会期：2023年3月14日(火)9:30~18:00
2023年3月15日(水)9:30~16:30



お問い合わせ先：株式会社ハイエレコン

TEL 082-279-8001

E-mail hek30info@hek.co.jp

HP <https://www.hek.co.jp/>

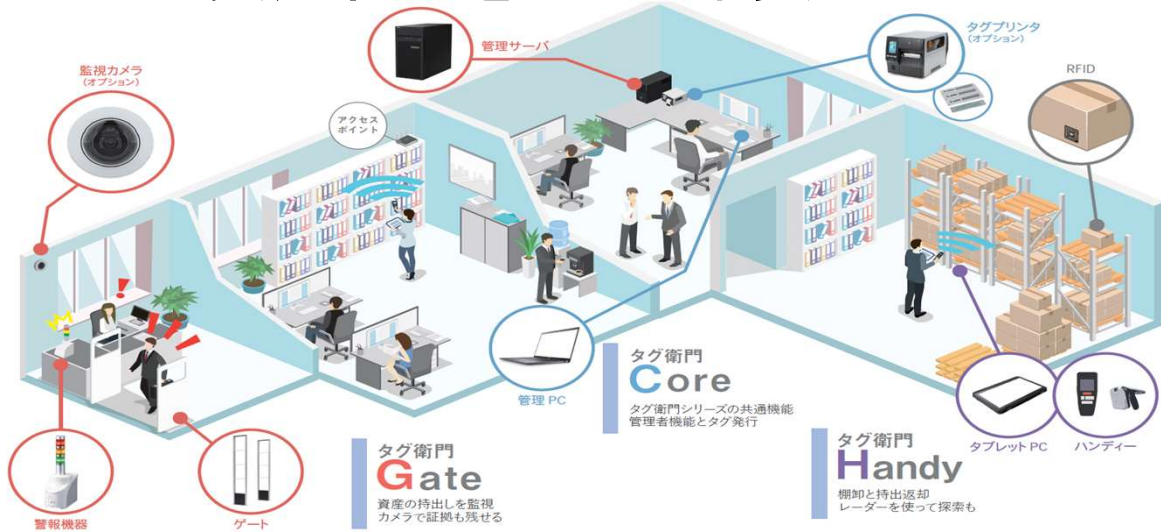


RFIDを使った備品管理パッケージ



タグ衛門

備品管理をもっと効率的に
資産管理をもっと確実に



 **smart@scale**
スマートアットスケール

計量現場を
「あっ！」という間に
スマート化

手ばかり業務に特化した
配合管理システム

point 01

計量器とシステムを
リアルタイムに連携



システムで計量値を確認し、
指示通りに計量を行うことができます。

point 02

原料入荷～配合・投入
作業までを見える化



原料の入出庫の情報はもちろん、
配合・投入作業の進捗状況も
確認することができます。

point 03

原料の徹底した
期限管理を実現



未開封と開封後の異なる期限管理
や賞味期限以外の複数の期限
情報を設定することができます。

